

MPU用プラスチックICパッケージの現状と展望

昨年10月、当社はプラスチックICパッケージ事業への参入を決定し、従来のセラミックパッケージに止まらず、今後は総合ICパッケージサプライヤーとして広く顧客の要求に応えていくことを表明いたしました。その量産計画に若干の変更がありましたので設備投資の内容と併せ、下記お知らせします。

1. 生産体制

次のとおり、量産(50万個/月以上)の立ち上げは当初予定より半年強ずれ込みますが、逆に500万個/月、1,000万個/月の体制は一年強早まる予定です。

平成8年10月時点での計画	現時点での計画
平成8年7月～平成9年6月 開発・試作 ～5万個～10万個/月	現在 20万個/月の生産体制構築済み。 (～10万個/月の量産試作品を納入中)
平成9年7月～平成11年12月 量産 50万個～500万個/月	平成10年3月～ 50万個/月 同年6月～ 100万個/月
平成12年～ 500万個～1,000万個/月	同年9月～ 200万個/月 同年12月～ 300万個/月 平成11年12月～ 500万個/月 平成12年12月～ 1,000万個/月

2. 設備投資

上記生産体制を整える為、従来から小牧工場(愛知県小牧市)で生産しているセラミックICパッケージの生産は、今年末迄に関連会社の中津川セラミック(岐阜県中津川市)、可児セラミック(岐阜県可児市)、飯島セラミック(長野県飯島町)へ移管します。

一方、小牧工場では、当移管により空いた第12工場の内部のレイアウトを変更し、新たに設備を導入することにより、プラスチックICパッケージの専用工場とします。この時点(平成10年12月末)で300万個/月の生産体制が完成します。更に、次の段階では既存の第3・第6工場をスクラップ&ビルドして、新たに5階建てのプラスチックICパッケージ専用工場を建設します。これにより、平成11年12月末にはトータルで、500万個/月の生産体制を予定しています。

今年度から3年間の全社の設備投資額は約900億円を予定していますが、その内プラスチックICパッケージ関連の設備投資額は約500億円に達する見込みです。

